

四会富仕电子科技股份有限公司

关于与 CMK 集团签订《战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本协议属于协议各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

2、本协议的签订不涉及具体金额，对公司 2021 年及后续年度财务状况和经营业绩的具体影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告“四、其他相关说明”。

一、协议的基本情况

1、签订战略合作协议的概述

公司下游应用领域以工业控制、汽车电子为主，为适应汽车电子行业发展需要，加速技术的引进、吸收与创新，进一步满足客户需求，提升公司综合竞争力，2021 年 8 月 6 日，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）与日本シイエムケイ株式会社、新昇电子（香港）有限公司（以下简称“CMK 集团”）共同签署了《Strategic Alliance Agreement》（以下简称“本协议”），各方本着优势互补、合作共赢的原则，就集合和发挥各自优势、谋求共同发展达成了一致意向。

CMK 集团是主营印制电路板研发、生产与销售的日本上市公司，以汽车电子

电路板制造著称，产品以 HDI、高多层等为主。根据 N.T.Information 的统计，2018 年其汽车 PCB 收入高达 6.28 亿美元，为全球最大汽车 PCB 制造商。自 2013 年以来，公司与 CMK 集团构筑了长期良好的交易业绩和信赖关系。为实现资源互补，共同做大做强汽车类 PCB 业务，双方决定在平等、互利的基础上建立战略合作伙伴关系。

2、协议对方的基本情况

(1) 日本シイエムケイ株式会社

公司名称	日本シイエムケイ株式会社 (英文名: CMK Corporation Ltd.,)
所在地	東京都新宿区西新宿 6-5-1
证券信息	东京证券交易所 市场第一部 (证券代码: 6958)
代表取締役	大澤 功
成立时间	1961 年 2 月
注册资本	22,306 百万日元 (约人民币 13.20 亿元)
主营业务	印制电路板的研发、生产与销售
与公司的关联关系	与公司不存在关联关系

(2) 新昇电子 (香港) 有限公司

公司名称	新昇电子 (香港) 有限公司 (英文名: CMKC(Hong Kong)Limited)
所在地	Flat/RM 1215 12/F Exchange Tower 33 Wang Chiu Road Kowloon Bay
董事	萩原 正芳
成立时间	2001 年 2 月
注册资本	150,043 千元港币
主营业务	印制电路板及其他材料的贸易
与公司的关联关系	与公司不存在关联关系

注: 新昇电子 (香港) 有限公司为日本シイエムケイ株式会社的全资子公司。

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

本协议仅为意向性协议，无需提交公司董事会、股东会审议。协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、协议的主要内容

1、合作各方

甲方: 日本シイエムケイ株式会社

乙方: 四会富仕电子科技股份有限公司

丙方：新昇电子（香港）有限公司

2、主要合作内容

(1) 在产品合作、质量、成本、人员交流、联合采购等方面建立全方位的合作体系；

(2) 通过定期交流和项目等形式，分享各自在业务方面的经验、技术和方法等；

(3) 在印刷线路板业务方面进行信息交流、人力资源开发、联合研究等方面展开合作。

3、保密条款

(1) 未经另一方事先同意，双方不得向第三方提供、披露或泄露另一方基于双方合作所提交的信息，或将该等信息用于所规定项目之外的其他目的；

(2) 本协议因其规定的有效期满而失效，双方仍应承担前款所规定的保密义务。

三、战略合作对公司的影响

CMK 集团以汽车电子电路板制造著称，本次与 CMK 集团签订战略合作协议，双方本着“资源共享、优势互补、合作共赢”的原则建立战略合作伙伴关系，共谋发展推动双方各自产业链延伸与渠道建设，打造高品质汽车用 PCB 核心供应商，共同为汽车工业提供 PCB 全方位解决方案，为公司未来在汽车电子领域的高端化、多元化及长远发展奠定基础，为提高公司核心竞争力、扩大在汽车电子领域的影响力，进一步巩固公司的行业地位起着积极作用，符合公司战略发展需要。

四、其他相关说明

1、公司近三年已披露的框架协议或意向协议进展情况

协议名称	交易对方	披露日期	进展情况
年产 200 万平方米高可靠 5G 通信电路板项目投资协议书	四会市人民政府	2020 年 9 月 15 日 (公告编号：2020-026)	正常履行中

2、本次协议签订前三个月内，控股股东、持股 5%以上股东持股未发生变动；截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股 5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

五、风险提示

1、本次签订的协议属于合作各方针对战略合作达成的合作意向，属于框架

性、意向性协议，具体合作范围与方式等事项尚需合作各方进一步落实，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

2、本协议的签订不涉及具体金额，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；对公司后续年度财务状况和经营业绩的具体影响存在不确定性。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、《Strategic Alliance Agreement》。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021年8月6日